

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

#### 暨

### 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月发布了《“提质增效重回报”行动方案》。

根据行动方案，公司积极开展和落实各项工作，取得了良好的成效。公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行总结评估，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

#### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司上市 20 多年来坚持聚焦做强主业，持续提升经营质量，公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以 IDM 模式（设计与制造一体化）为主要发展模式的综合型半导体产品公司。根据集微咨询分析师团队发布的《中国半导体企业 100 强（2024）》排行榜，公司荣列“中国半导体企业 100 强（2024）”第八位。

2025 年，公司持续发挥 IDM 模式的优势，聚焦高端客户和高门槛市场；重点瞄准当前电动汽车、新能源、算力和通讯、机器人等产业快速发展的契机，抓住国内高门槛行业和客户积极导入国产芯片的时间窗口，利用我们有多条不同尺寸硅芯片产线和化合物产线的特点持续拓展工艺技术与产品平台，不断在特色工艺平台建设、新技术新产品开发、与战略级大客户合作等方面加大投入，产品结

构调整的步伐进一步加快。

2025年，公司实现营业总收入130.52亿元，比上年同期增长16.32%；实现归属于母公司股东的净利润3.99亿元，比上年同期增长81.27%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.72亿元，比上年同期增长47.82%。2025年，公司电路和器件成品的销售收入中，已有超过80%的收入来自大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场，较2024年提高了约4个百分点，公司产品结构持续向高附加值领域倾斜，高门槛市场的客户粘性与订单规模稳步提升，为后续盈利能力的增强和抗周期波动能力的改善奠定了坚实基础。

2026年，公司将在《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》、国家“十五五”发展规划等政策的指引下，坚定不移走“设计制造一体化”（IDM）发展道路，继续加大对模拟电路、功率半导体、MEMS传感器、第三代化合物半导体等方面的投入，大力推进系统创新和技术整合，积极拓展汽车、新能源、工业、通讯、大型白电、电力电子等中高端市场，不断提升产品附加值和产品品牌力，提高经营质量，努力为国家集成电路产业发展做出贡献。

## 二、持续研发创新投入，加快发展新质生产力

### （一）持续高强度的研发创新投入

公司通过长期高强度的产品和技术研发创新投入，建立了可持续发展的产品和技术研发体系。当前，公司研发项目主要围绕先进的车规和工业级电源管理产品（芯片设计、芯片工艺制造）、车规和工业级功率半导体器件与模块技术（含化合物SiC和GaN的芯片设计、制造、封装）、MEMS传感器产品与工艺技术平台（芯片设计、芯片工艺制造和封装）、车规和工业级的信号链（接口、逻辑与开关、运放、模数\数模转换等）混合信号处理电路（含芯片设计和芯片制造）、光电系列产品（发光二极管及其它光电器件的芯片制造及封装技术）等五大方面进行。

2025年，公司研发投入为11.72亿元，同比增长8.16%，研发投入占营业收入的比重为8.98%。截至2025年末，公司共拥有专利1,303件，较上年同期增加57件，其中：发明专利627件，较2024年末增加29件。

2025年，公司入选中华全国工商业联合会发布的“2025民营企业研发投入500家”和“2025民营企业发明专利500家”两大权威榜单。在“发明专利500

家”榜单中，公司跻身“软件和信息技术服务业”发明专利数量前五位。

2026年，公司预计研发投入占营业收入的比重将保持在8%-10%。公司将继续保持高强度的产品和技术研发创新投入，持续提升专利质量与成果转化效率，不断丰富现有产品群，持续推出高性能、高质量和富有成本竞争力的产品，坚持创新驱动发展，加快培育新质生产力，进一步增强核心竞争力。

## **（二）持续加大对大功率 IGBT、模拟电路、MEMS 传感器、第三代半导体芯片等产能建设的投入**

近年来，公司持续加大对12英寸IGBT和模拟电路芯片制造能力、8英寸MEMS传感器芯片制造能力、6英寸SiC功率器件芯片制造能力以及对功率模块封装能力的投入，为“十五五”期间公司主营业务保持较快增长奠定基础。

2025年四季度，公司新建的“8英寸SiC功率器件芯片生产线项目一期”实现通线，已形成月产5000片8吋SiC功率器件芯片的生产能力。该产线成功突破了8英寸碳化硅晶圆在制造过程中的多项核心工艺难题。该产线将重点服务于新能源电动汽车、光伏、储能、充电桩、大型白电、算力服务器电源、工业电源等应用场景，助力客户提升系统能效与功率密度。

为加快发展汽车、工业、大型服务器、机器人、通讯等产业领域关键芯片，进一步完善公司在半导体产业链的布局，公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人民政府于2025年10月18日在厦门共同签署了《战略合作协议》：各方合作在厦门市海沧区投资建设一条对标国际领先水平、以IDM模式运营、拥有完全自主知识产权的12英寸高端模拟集成电路芯片生产线。该项目一期投资规模100亿元人民币，建成后将形成年产24万片12英寸高端模拟集成电路芯片的生产能力。目前，“12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目一期”已于2025年底开工，计划于2027年四季度初步通线并投产。

2026年，公司将结合市场需求和自身资金状况，统筹安排现有满产产线的技术升级和产能优化；加快已有但未满产的产线产能爬坡和良率提升，使其尽快达产并贡献正向收益；持续推进在建生产线按计划节点逐步实施。

## **（三）完善人才培养和激励机制**

2025年，公司在人才队伍建设方面持续发力，不断加强人才梯队建设，深化产学研合作，持续引进高端科技人才。目前，公司已拥有一支超过800人的集

成电路芯片设计研发队伍、超过 3,600 人的芯片工艺、封装技术、测试技术研发和产品应用支持队伍。公司建立了较为有效的技术研发管理和激励制度，保证人才队伍的稳定，为公司在竞争激烈的半导体行业中保持持续的技术研发能力和技术优势奠定了基础。截至 2025 年末，公司共有技术、研发人员 4,475 人，占公司总人数的 40.27%。

2026 年，公司将进一步完善人才培养体系和激励机制。一方面，公司持续推进内部讲师制度，定期升级培训方法和课程内容，通过传、帮、带全面提升员工的综合素质和职业技能；另一方面，公司积极鼓励员工通过再教育取得学历或专业上的进一步提升，为符合条件的员工提供教育费用资助，助力优秀人才进步成长。

### **三、加强投资者沟通，重视投资者回报**

#### **（一）持续现金分红，重视投资者回报**

公司高度重视投资者回报，以长期、稳定、可持续发展为基本立足点，基于公司实际经营情况同时兼顾投资者合理回报，综合考虑发展阶段、战略规划和未来资金需求等因素，制定并执行利润分配方案。公司在符合《公司章程》规定的利润分配前提下，优先采用现金分红进行利润分配。公司于 2024 年 4 月制定并披露《股东分红三年（2024-2026 年）回报规划》，进一步提升分红透明度和可操作性，保障股东回报的落实。

2025 年，公司实施完成了 2024 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 1,664,071,845 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 66,562,873.80 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.27%。最近三个会计年度（2022 年度至 2024 年度），公司累计实施现金分红约 2.08 亿元，占最近三个会计年度归属于上市公司股东的净利润的平均值的 50.51%。

2026 年 4 月，公司董事会拟定了 2025 年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），合计拟派发现金红利 133,125,747.60 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 33.40%。本次利润分配预案兼顾公司发展战略与股东长远利益，将于 2025 年年度股东会审议通过后 2 个月内实施。

2026 年度，公司将继续努力提升经营业绩，为投资者创造长期价值。公司将继续统筹好长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，切实执行《股东分红三年（2024-2026 年）回报规划》，落实科学、持续、稳定的股东回报机制，优先采用现金分红进行利润分配，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

## **（二）加强投资者沟通，精准传递公司价值**

为增强与资本市场的双向沟通，公司持续丰富投资者交流方式和渠道，通过股东会、业绩说明会、主题投资者交流活动、投资者关系热线电话及邮箱、上证 e 互动平台、上证路演中心、公司官网及微信公众号等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略、企业文化和 ESG 等公司价值信息，加强投资者对公司价值及经营理念的认同感，提振投资者信心。2025 年，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 59 份，召开股东会 5 次，通过上证路演中心召开业绩说明会 3 次，日常接听投资者来电超三百次。

为规范公司市值管理行为，切实推动公司提升投资价值，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司董事会于 2025 年 4 月制定了公司《市值管理制度》，明确市值管理的目的、基本原则、责任机制、主要方式、禁止行为与监测预警机制和应急措施，致力于提升公司投资价值和股东回报能力。

2026 年，公司将继续以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，增强信息披露有效性和透明度；进一步加强投资者沟通，计划 2026 年举办不少于 3 次投资者说明会或投资者沟通会；不断丰富投资者交流方式和渠道，努力向投资者合规、精准传递公司价值信息，增加投资者对公司价值及经营理念的认同感，提振投资者信心；传递理性投资、价值投资和长期投资理念，保护中小投资者的合法权益，积极维护资本市场健康稳定发展，参与共建良好市场生态。

## **四、坚持规范运作，提升治理水平**

2025 年，为全面落实新《公司法》及其配套监管规则、完善治理结构，公司结合实际情况对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等 14 项治理制度进行系统性修订。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

同时，公司第八届董事会任期届满后，公司按照法定程序及时完成了换届选举。公司第九届董事会由 15 名董事组成，其中包括 5 名独立董事、1 名职工代

表董事。公司第九届董事会成员在人数和结构上都进行了相应调整，由原先的“6名内部董事和6名外部董事（含4名独立董事）共12名董事”扩充为“7名内部董事、7名外部董事（含5名独立董事）和1名职工代表董事共15名董事”，进一步丰富董事会的治理结构。公司内部董事均为半导体资深从业人士，在半导体行业扎根近四十年，具备卓越的专业技术水平和经营管理能力；两名外部董事为公司第二大股东国家集成电路产业基金推荐的优秀专业人士，具有开阔的全球视野、专业的管理经验以及良好的职业素养；五名独立董事分别为会计类、经管类、半导体集成电路专业和工业控制领域的专家、教授，独立履行职责，充分发挥专业优势，为董事会把好“决策关”，监督并确保管理层有效履行管理职责，维护公司及中小股东利益；一名职工代表董事保障员工诉求得到充分表达。本次董事会换届顺利完成，进一步夯实了规范运作基础，促进了公司治理水平的提升。

报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，切实保障独立董事的知情权。公司独立董事勤勉尽责，积极出席相关会议，到公司进行现场办公和考察，深入了解公司的生产经营情况、董事会和股东会决议执行情况等，对重点事项主动问询，运用专业知识为董事会决策提供专业、客观的意见，充分发挥了指导和监督的作用，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2025年，公司共召开了5次股东会、13次董事会和4次监事会以及3次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、4次提名与薪酬委员会会议、1次战略与投资委员会会议，审议了报告期内公司发生的重大事项，包括定期报告、利润分配、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金管理、章程及治理制度修订、董事会换届等议案。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管规则的要求，进一步完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，持续规范公司运作，加强信息披露工作，不断提升公司治理水平。同时，公司将继续组织实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”积极参加交易所、证监局和公司内部的合规培训，计划不少于15人次，督促其学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识并及时了解监管动态，不断强化“关键少数”的诚信自律法治意识，确保“关键少数”合规履职，提升

公司整体规范运作水平。

## 五、践行 ESG 理念，推进可持续发展

公司高度重视环境、社会和公司治理工作，构建了符合自身发展的 ESG 管理架构，将 ESG 融入企业可持续发展战略。公司已连续 17 年发布社会责任相关报告，并于 2023 年起发布《可持续发展报告》。2025 年 4 月，公司发布了《2024 年度可持续发展报告》，详细披露了公司在环境、社会和治理等可持续发展方面的实践和绩效。

2025 年，公司进一步完善 ESG 治理架构，修订《董事会战略与投资委员会议事规则》，明确董事会战略与投资委员会对 ESG 工作的指导与监督职责。当前，公司已构建起由“董事会&董事会战略与投资委员会—ESG 委员会—ESG 专项工作组”组成的三级治理架构，形成从战略规划到具体执行的完整闭环。

2026 年，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任，加强利益相关方沟通，完善 ESG 信息披露制度，提升 ESG 治理水平，赋能公司可持续发展。

## 六、风险提示

本次方案立足公司现阶段实际状况制定，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 25 日